

PCT/JP 2004/014739

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

18.10.2004

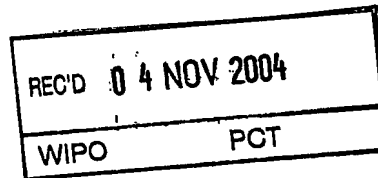
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 0 月 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 4 6 5 8 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 3 4 6 5 8 0]

出 願 人 日 本 電 気 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

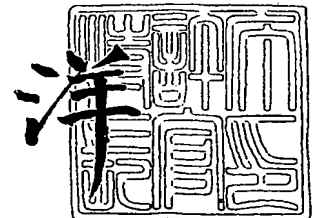


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 8 月 2 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 7 5 5 8 5

【書類名】 特許願
【整理番号】 35600275
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/60
H05K 3/32
【発明者】
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内
【氏名】 渡邊 真司
【発明者】
【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内
【氏名】 山口 幸雄
【特許出願人】
【識別番号】 000004237
【氏名又は名称】 日本電気株式会社
【代理人】
【識別番号】 100096253
【弁理士】
【氏名又は名称】 尾身 祐助
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003399
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9002137

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

第 1 主面および第 2 主面を有する絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の第 2 主面側に配置された第 1 の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装してなる電子デバイスにおいて、前記チップ部品の下面と側面とが前記絶縁樹脂層に接し、前記チップ部品の上面が前記絶縁樹脂層の第 1 主面側に露出する態様にて前記絶縁樹脂層が前記チップ部品を保持し、前記チップ部品の突起電極が前記第 1 の配線層と接続していることを特徴とする電子デバイス。

【請求項 2】

前記絶縁樹脂層の第 1 主面上に第 2 の配線層が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の電子デバイス。

【請求項 3】

前記第 2 の配線層にグランドパターンが形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の電子デバイス。

【請求項 4】

チップ部品を保持する絶縁樹脂層を複数層有していることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 5】

チップ部品を保持する絶縁樹脂層が第 1 主面を同じ向きに積層されていることを特徴とする請求項 4 に記載の電子デバイス。

【請求項 6】

チップ部品を保持する絶縁樹脂層が配線基板の両面に配置されていることを特徴とする請求項 4 または 5 に記載の電子デバイス。

【請求項 7】

積層された第 1 主面および第 2 主面を有する複数の絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の中の最下層ないし最内層の絶縁樹脂層の第 2 主面側に配置された第 1 の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装してなる電子デバイスにおいて、前記チップ部品の下面と側面とが最外層の絶縁樹脂層に接し、前記チップ部品の上面が最外層の絶縁樹脂層の第 2 主面側に露出する態様にて前記絶縁樹脂層が前記チップ部品を保持し、前記チップ部品の突起電極が前記第 1 の配線層と接続していることを特徴とする電子デバイス。

【請求項 8】

前記配線基板が、前記絶縁樹脂層以外の絶縁層と、前記第 1 の配線層または第 1 および第 2 の配線層以外の配線層とをさらに有していることを特徴とする請求項 1 から 7 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 9】

配線基板の最外層の絶縁樹脂層に入り込んだチップ部品の絶縁樹脂層から露出した部分はコーティング樹脂によって被覆されていることを特徴とする請求項 1 から 8 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 10】

前記チップ部品の突起電極が尖った先端部を有していることを特徴とする請求項 1 から 9 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 11】

前記チップ部品の突起電極がワイヤボンディング法により形成された金電極であることを特徴とする請求項 1 から 10 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 12】

前記絶縁樹脂層が、熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂に熱硬化性樹脂を添加した材料により形成されていることを特徴とする請求項 1 から 11 のいずれかに記載の電子デバイス。

【請求項 13】

第 1 主面および第 2 主面を有する絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の第 2 主面側に配置された第 1 の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装する工程を有す

る電子デバイスの製造方法において、前記工程では前記チップ部品を前記絶縁樹脂層へその第1主面側から押圧して押し込み前記チップ部品の突起電極を前記絶縁樹脂層を貫通させて前記第1の配線層に接続させるとともに前記チップ部品の少なくとも突起電極の形成面を前記絶縁樹脂層の樹脂にて封止することを特徴とする電子デバイスの製造方法。

【請求項14】

前記工程においては、加熱しつつ前記チップ部品の押圧を行うことを特徴とする請求項13に記載の電子デバイスの製造方法。

【請求項15】

前記工程においては、前記チップ部品または前記配線基板のいずれかに超音波振動を印加しつつ前記チップ部品の押圧を行うことを特徴とする請求項13または14に記載の電子デバイスの製造方法。

【請求項16】

前記工程に先立って、前記絶縁樹脂層の第1主面の少なくとも前記チップ部品による押圧個所に対してプラズマ処理または紫外線照射を行うことを特徴とする請求項13から15のいずれかに記載の電子デバイスの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】電子デバイスおよびその製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、電子デバイスおよびその製造方法に関し、特にフリップチップ方式によって半導体チップを配線基板へ実装した構造とその実装方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より半導体チップと配線基板とのフリップチップ方式による接続構造では、接続部の信頼性の問題が重要な課題の一つとなっている。

この信頼性向上手段として、通常半導体チップと配線基板との間に封止樹脂を注入することで接続部への応力を緩和する手段がとられている。樹脂による封止方法としては、半導体チップを配線基板上へフリップチップ実装した後に、液状の樹脂を流し込み硬化させるアンダーフィル方法が主流であった（例えば、特許文献1参照：第1の従来例）。

【0003】

この第1の従来例の液状のアンダーフィル樹脂を後から注入するフリップチップ実装方法について、図14を参照して説明する。図14（a）に示すように、配線基板は、絶縁層12上に形成された配線パターン2と、配線を覆うソルダーレジスト3から構成されており、一般的に、これらを多層に積み重ねた構造がとられている。

半導体チップの実装工程では、図14（b）に示すように、半導体チップ4の回路面上に配されたパッド（電極）上にバンパ5を形成し、配線基板上の配線パターン2の露出部分と半導体チップ4のバンパ5とを位置合わせして接合する。

図14（c）に示す次工程では、半導体チップ4と配線基板との間隙に、液状樹脂を注入し硬化させて半導体チップ4を封止するアンダーフィル17を形成してフリップチップ実装構造の半導体パッケージを完成させる。

【0004】

しかしながら、このようなアンダーフィル樹脂を後から注入する第1の従来例では、接続手段として金属拡散接合、金属熔融接合、金属含有樹脂ペーストによる接合等の種々の手段が用いられているが、何れの工法においても、実装時に半導体チップおよび配線基板に熱を加えるため、特に配線基板に有機基板を用いる場合において、実装後の温度が低下する際に半導体チップと配線基板の熱膨張係数の差に起因する応力が接続部に集中することから、接続部が破壊しやすい、あるいは信頼性の向上が困難である等の課題があった。

【0005】

他の製造工法としては、樹脂を予め配線基板上に塗布しておき、半導体チップ実装時にチップ加圧により半導体チップ上に形成されたバンパと配線基板上に形成されたパッドとが接触させた状態を保ちつつ、半導体チップと配線基板間の樹脂を接合と同時に硬化する工法が提案されている（例えば、特許文献2参照：第2の従来例）。

この第2の従来例の工法の製造方法について、図15を参照して説明する。まず、図15（a）に示すように、配線基板上の半導体チップ搭載個所に液状樹脂17aを供給する。樹脂の供給には、エア式のディスペンス装置が使われるのが一般的である。

【0006】

そして、バンパ5が形成された半導体チップ4を吸着穴19を有する実装ツール18によって吸着把持し、配線基板の配線に半導体チップ4の位置合わせを行う。次いで、図15（b）に示すように、半導体チップ4吸着把持させたまま実装ツール18を降下させ、バンパ5と配線パターン2を接触させる。そしてその状態を保ちつつ、半導体チップ4を加熱・加圧して、バンパ-配線間を接続するとともに半導体チップと配線基板間の樹脂を硬化させてアンダーフィル17を形成する。この第2の従来例でも、実装時の熱によって基板が膨張することは変わらないが、常温に戻った際の基板収縮に伴う応力は、アンダーフィル17に分散されることから、前述の実装後に樹脂を注入・硬化させる工法の課題である半導体チップと配線基板の熱膨張係数差に起因する接続不良は抑制できる。さらに、

bumps 5 と配線基板の配線と接触のみによる低温化接続が可能であるという特徴も有している。しかしながら、近年では携帯端末機器での半導体装置の薄型化要求が激しく、半導体チップ単体の薄型化が必須となっており、チップの厚みが薄くなるに伴って実装時に半導体チップ実装装置の実装ツールに樹脂が這い上がり、ツールに樹脂が固着するという問題が顕著化している。

【0007】

而して、近年の電子機器の高性能化・高機能化に伴い、高周波化・高密度化の要求は益々高まっている。特に携帯電話、無線LAN等の多大なノイズ発生の伴うアナログ回路が混在した電子機器や、高クロック化が進むパソコンのマザーボード等においては、配線基板内の配線に伝わるノイズは、そのノイズレベルによっては機能障害を引き起こす。そのため、如何にノイズを低減あるいは遮蔽するかが重要な課題となっている。

そこで、このノイズの影響を低減する目的で、コア層配線層に電源・グランドパターンを配するとともに、最外配線層についても可能な限りグランドに接続したベタパターンを配す手法が活用されている。この従来技術による半導体チップの実装例について、図16を用いて説明する。図16(a)は、最上層配線層の平面図であり、図16(b)は半導体チップの実装部近傍の断面図である。半導体チップ4の bumps は、最上層配線層に形成されたパッド20に接続され、配線パターン2を介してビアホールランド21に接続されている。また、最上層配線層には、前述したノイズの影響低減を目的としたグランドパターン2aがベタパターンにて形成されている。配線基板の内層には、パッド20に接続された半導体チップ4からの信号を伝達する配線パターン2が形成されており、配線基板内ではこれらの配線パターンを介して他の電子部品の端子と接続される。ここで、他の電子部品と接続される配線パターン2は、最上層に設けられたグランドパターン2aの下層を通すことで前述のノイズの影響を低減している。

複数配線層を有する配線基板内の配線パターンの層間接続は、ビアホール22を介して行われ、個々の配線パターンはビアホール22を通して内層配線層を通り、再度ビアホールを介して表層に引き出され、他の部品の該当端子と接続される。

【0008】

また、従来の実装方法により半導体チップを積層して従来の実装方法により製造したBGA(ball grid array)の例を図17に示す。図17(a)は、最上層配線層の平面図であり、図17(b)は従来のBGAの断面図である。図16に示した場合と同様に、半導体チップ4の bumps は、最上層配線層に形成されたパッド20、配線パターン2を介してビアホールランド21に引き出され、ビアホール22を介して下層配線へ落とされる。最上層の絶縁層12の外周部には、ワイヤボンディングのためのパッド23が形成されている。半導体チップ4上には他の半導体チップ16がフェースアップ状態で搭載されており、他の半導体チップ16の電極(図示なし)とパッド23間はボンディングワイヤ24により接続されている。

【特許文献1】特開2000-156386号公報(図6)

【特許文献2】特開平4-82241号公報(第1図、第3図)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

図14に示した第1の従来例の製造工法では、特に配線基板に有機系材料を絶縁層として用いる場合において、半導体チップの熱膨張係数が約2~3ppm/℃であるのに対し、有機配線基板のそれは約10~50ppm/℃と非常に大きな差があり、実装時の加熱後、チップの収縮量の5倍以上の量の配線基板収縮が発生するため、接合部に大きな応力集中が発生する。この応力集中は、チップ上の電極に形成された bumps と前記電極間での破壊、前記電極の破壊、更には bumps と配線基板上のパッドとの接続界面破壊等の種々の接合部破壊や信頼性低下を引き起こすという問題がある。また、これらの不良は熱膨張係数の差に起因しているため、チップサイズが大きいくればこれらの不良の発生率は上昇する傾向にあり、特に、 bumps がチップ周辺のみ配されたペリフェラル構造の大型チップへの採用は非常に困

難となる。

【0010】

次に、図15に示した第2の従来例の製造工法における課題について説明する。この方法においても、実装時の熱による基板の膨張は変わらないが、半導体チップ実装時に、実装ツールでチップを把持したまま樹脂を硬化させることから、常温に戻った際の基板収縮に伴う応力が樹脂で分散され、前述の実装後に樹脂を封入する工法の課題である半導体チップと配線基板の熱膨張係数差に起因する接続不良を抑制できるという特徴を有している。しかしながら、近年では携帯端末機器での半導体装置の薄型化要求が激しく、半導体チップ単体の薄型化が必須となっており、チップの厚みが薄くなるに伴って実装時に半導体チップ実装装置のチップ吸着ツールに樹脂が這い上がり、ツールに樹脂が固着するという問題が顕在化している。これは、配線基板上に事前に塗布した樹脂が、半導体チップを加圧・加熱する工程中に押し出され、チップ周囲にはみ出してくる際、チップの側面から樹脂が這い上がりチップを吸着・加圧している実装装置の加熱されたツールへ接触し、硬化するに至り、次回以降の実装が不可能となるという問題を生じさせる。

【0011】

この問題が生じる理由を、図18の薄型チップを実装ツールで吸着した状態の模式図を用いて説明する。実装ツール18は、樹脂が吐出量ばらつきにより半導体チップ4の上面まで這い上がった場合を考慮し、半導体チップ4よりも十分小さく設定されている。しかしながら、半導体チップ4のチップ厚が十分薄い場合、図18のように実装ツールがバンプ5形成部よりも小さいと、実装ツール18により半導体チップ4を加圧する際、チップが割れるという問題が発生する。そのため、薄型チップの場合には、実装ツール18のサイズを少なくともバンプ5を包含するサイズまで大きくする必要があり、チップ上面まで這い上がった樹脂が実装ツールに付着・硬化する確率は大幅に上昇する。

【0012】

更に、チップ厚が薄い分、樹脂の這い上がりもシビアになるため、樹脂の吐出量のばらつきを極限まで抑える必要がある。一般にチップ厚が0.15mm以下となると、液状樹脂では樹脂量のコントロールが難しく対応が困難となることが知られている。

上記した、樹脂の実装ツールへの固着防止、樹脂の適量制御という観点から、フィルム状の樹脂材料が提唱されており、熱硬化型、熱可塑型、あるいは熱硬化・熱可塑混合型等の種々の樹脂材料が検討されている。しかしながら、アンダーフィル用途のフィルム状樹脂材料は、フィルム形態特有の課題、例えばフィルム樹脂を配線基板上に貼り付ける際の貼り付け性、気泡の発生、本硬化後の接続信頼性等、多くの課題を抱えている。これらフィルム形態の樹脂は、未だ開発途上であるというばかりでなく、非常に材料価格が高価であるという課題も有している。しかも、フィルムタイプの樹脂材料を採用する場合には、従来の樹脂のデイス Pens 装置が使用できず、新たにフィルム貼り付け機を設備投資しなければならないという課題も有しており、製造コストの低減も大きな課題となっている。

【0013】

次に、従来の実装方法により製作した電子デバイスの構造上の問題点について説明する。基板表層配線への部品を実装する従来の実装構造においては、図16、図17に示されるように、多くの信号線を内層配線層に落とす必要があり、層間接続のためのビアホールを介して表層配線と内層配線とを接続していた。そのため、一般的な数百ピンクラスの半導体チップを実装する場合においても、膨大な数のビアホールが必要となる。特に、図16に示される従来例のように、高周波化に対応するため基板の最上層にグランドパターンを形成した構造の場合にはより顕著であり、ほぼ全ての信号線を内層に落とさなければならないことになる。

ここで、ビアホールランド径は先端レベルにおいても200 μ m程度のサイズが必要であり、ビアホール数が増加すればする程、ビアホールによる配線層を占める面積が増加する。そのため、配線エリアが制限されたり迂回配線が余儀なくされたりすることから配線の引き回しが非常に困難となり、場合によっては配線層数を増やさなければならず、配線長も更に増加することとなる。よってビアホール数のミニマム化は、高周波化への大きな課

題となっている。

【0014】

更にビアホール数の増加は、最上層でのビアホール配置エリア/配線エリアの占有率の上昇も引き起こすことから、部品同士の実装間隔への制約も大きくなり、部品の高密度実装の面においても大きな弊害となっている。例えば、図17に示されるBGAでは、ボンディングパッドが半導体チップ16から離れた位置に配置されることから、ボンディングワイヤ長が長くなると共にチップサイズでのパッケージングが困難となる。

また、コスト面においても、ビアホール形成はレーザ等による絶縁層の個別穴開けが主流であり、当然ながらビアホール数が増加するに比例して加工数が増加するため、基板製造費は上昇する。層数増も大きなコストアップ要因となっている。

一方、信頼性面から見た場合にも、ビアホールは配線基板において最も破壊しやすい箇所であり、製造ばらつき等による品質面からもビアホール数は少なければ少ないほど望ましく、信頼性面でもビアホールの増加は不利となる。

【0015】

本発明の目的は、第1に、実装後の半導体チップと配線基板の熱膨張係数差に起因する接続部破壊を抑制することであり、第2に、封止樹脂の這い上がりによって実装ツールへ樹脂が固着するのを防止することであり、第3に、実装工程での樹脂材料供給を不要ならしめることであり、第4に、ビアホール数を最小限に抑えることであり、第5に、高周波化に対応すべく伝送線路長を最短化することであり、第6に、デバイスの信頼性を向上させることであり、第7に、低コストで電子デバイスを製造できるようにすることであり、第8に、電子デバイスの薄型化・小型化を実現できるようにすることである。

【課題を解決するための手段】

【0016】

上記の目的を達成するため、本発明によれば、第1主面および第2主面を有する絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の第2主面側に配置された第1の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装してなる電子デバイスにおいて、前記チップ部品の下面と側面とが前記絶縁樹脂層に接し、前記チップ部品の上面が前記絶縁樹脂層の第1主面側に露出する態様にて前記絶縁樹脂層が前記チップ部品を保持し、前記チップ部品の突起電極が前記第1の配線層と接続していることを特徴とする電子デバイス、が提供される。

換言すると、本発明によれば、第1主面および第2主面を有する絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の第2主面側に配置された第1の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装してなる電子デバイスにおいて、前記チップ部品が前記絶縁樹脂層へその第1主面側から絶縁樹脂層内へ進入し前記チップ部品の突起電極が前記絶縁樹脂層を貫通して前記第1の配線層と接続していることを特徴とする電子デバイス、が提供される、ということである。

また、上記の目的を達成するため、本発明によれば、第1主面および第2主面を有する絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層の第2主面側に配置された第1の配線層とを有する配線基板に突起電極を有するチップ部品を実装する工程を有する電子デバイスの製造方法において、前記工程では前記チップ部品を前記絶縁樹脂層へその第1主面側から押圧して前記チップ部品の突起電極を前記絶縁樹脂層を貫通させて突起電極を前記第1の配線層に接続するとともに前記チップ部品の少なくとも突起電極の形成面を前記絶縁樹脂層の樹脂にて封止することを特徴とする電子デバイスの製造方法、が提供される。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、半導体チップを配線基板にフリップチップ実装する方法において、半導体チップの端子に形成された突起電極であるバンプを配線基板の絶縁樹脂層を貫通させ、内層配線層に形成された接続パッドと前記突起電極とを接続させる方法を採用することにより、樹脂を後から注入・硬化させる工法で課題となる実装後の半導体チップと配線基板の熱膨張係数差に起因する接続部破壊を抑制することができる効果と、半導体チップ実装前に供給するアンダーフィル材として液状樹脂を適用する際に課題であった樹脂の這い

上がりによる実装ツールへの樹脂固着を防止できる効果とを同時に実現できる。

更に、半導体チップの封止を目的とする樹脂材料を配線基板の材料により構成していることから、実装工程での樹脂材料供給が不要であり、樹脂材料費、樹脂供給・キュア等の工程加工費、また、それに付随する設備投資が不要となり、実装コストを大幅に削減できる。

また、本実装構造では、半導体チップが配線基板に埋め込まれた構造をとることが可能であり、薄型・小型の半導体パッケージや、埋め込まれたチップ上に他の部品を実装する3次元の高密度実装構造が可能な電子部品基板をも実現可能とすることができる。

【0018】

また、電子部品の電極を直接内層パターンに接続する実装構造を採用したことにより、ビアホール数を大幅に削減できる。これに伴って、本発明によれば、以下の効果を楽しむことができる。

- (1) 配線エリアの確保が可能となり、特性を考慮した配線引き回しが容易となる。
- (2) 伝送線路長、フライングワイヤ長のミニマム化が可能となる。
- (3) ビアホール数削減に伴う基板製造費低減、配線層の層数低減による薄型化・基板の低価格化が実現できる。
- (4) 小型化（基板の小型化・薄型化・部品の実装密度向上）が実現できる。
- (5) 信頼性の向上を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

次に、本発明の実施の形態について、図を参照しながら詳細に説明する。

図1は、本発明の第1の実施の形態を示す断面図であって、図1(a)は、本発明の一つの特徴であるバンプが貫通する層として、熱可塑性の絶縁樹脂層1をコア層とした配線基板の断面図である。この配線基板は、絶縁樹脂層1の両面に銅箔を形成した銅張基板を用いて作製されたものであり、サブトラクティブ工法などによりパターンニングされた配線パターン2と、その両面の最外層にコーティングされたソルダーレジスト3を有する一般的な製造工法により製造されたものである。

銅箔配線層の形成は、加熱プレス積層法や金属蒸着後にメッキ形成する工法も適用でき、導通のためにバンプと直接接触、あるいは金属接合される蒸着金属には、Auなどの酸化しにくい材料を選定することで信頼性の向上も期待できる。

また、絶縁樹脂層1は、半導体チップやバンプ接続部の信頼性を確保する目的のため、熱膨張係数が半導体チップに近い材料を選定した方がよく、シリカ等のフィラーを含有させるか、任意に熱膨張係数を制御して製造可能な液晶ポリマー等を使用する等の方法にて熱膨張係数を調整しておく。

【0020】

図3(a)は、本発明において実装される半導体チップ4の断面図である。半導体チップ4の回路面には、内部回路に接続されたパッド〔図3(a)では図示省略〕が形成されており、そのパッド（電極）上には先端部が尖ったバンプ5が形成されている。このようなバンプは、図3(b)、(c)に示すワイヤボンディング法や打ち抜き法により形成することができる。すなわち、図3(b)に示すように、キャピラリ6に把持された金ワイヤ7の先端部に金ボール8を形成しておき、この金ボールを半導体チップ4の回路面に形成されたパッド4aにキャピラリ6により押し付けることにより接合させ、金ワイヤを引きちぎりバンプ5を形成する。金ボールは、キャピラリから金ワイヤを突出させておき、トーチと金ワイヤ間に高電圧をかけスパークさせることにより、金が溶融し固まる際に表面張力で球状となって形成されるものである。

あるいは、図3(c)に示すように、円錐形の凹部9aを有するポンチ9とダイス10とによりリボン材料11を打ち抜き、その打ち抜き部を半導体チップ4の回路面に形成されたパッド4aに接合させ、バンプ5を形成する。なお、熱可塑性の絶縁樹脂層1は、半導体チップ4実装時の加熱により十分軟化するため、バンプの先端は必ずしも尖っている必要はなく、高温はんだバンプ、銅バンプ、金バンプ等も利用でき材料に対する制約も無

い。しかしながら、絶縁層樹脂を貫通させ易いという点や、接続信頼性を確保し易いという点において、先端を尖らせた形状を採用する方が加工条件にマージンができることから、初期歩留まりや信頼性の面では有利である。

【0021】

図1(b)は、図1(a)で示した配線基板に図3(a)に示す半導体チップを実装した状態を示した断面図である。配線基板のコア材である熱可塑性の絶縁樹脂層1に、図3のバンプ5の形成された半導体チップ4を、バンプ5が絶縁樹脂層1を貫通して下層配線に接続されるとともに、絶縁樹脂層1内に埋め込まれるように実装した構造としている。

【0022】

次に、本実装構造の実装方法について説明する。配線基板の半導体チップ4と絶縁樹脂層1との密着性を上げるため、予め絶縁樹脂層1の表面をプラズマ処理や紫外線照射で活性化しておくことが望ましい。

配線基板上の、半導体チップ4が実装される箇所には、ソルダーレジスト3が塗布されずに開口している。配線基板上に設けた位置合わせマークと、実装装置の実装ツールに吸着把持された半導体チップ4とを画像処理して位置合わせを行う。この際、位置合わせマークは上層の配線層に形成してもよいが、上層と下層とのパターン位置を精度よく形成することは困難であることから、端子ピッチが微細である場合には、下層の配線に位置合わせマークを設けておくことが望ましい。また、適用する熱可塑性樹脂が透明でない場合には、上側から認識可能とするため、位置決めマーク部には銅張り前に絶縁樹脂層1にパンチング等で貫通穴を設けておくか、銅張り／パターン形成後に、レーザ工法、あるいはフォトリソ／エッチング工法等により位置決めマーク部の絶縁樹脂を開口しておく。実装装置の実装ツールは加熱および加圧が可能な構造とし、吸着把持された半導体チップ4を絶縁樹脂層1が十分軟化する温度まで加熱しながら、位置合わせされた配線基板に加圧する。この際、半導体チップ4に加えた温度を効率よく配線基板に伝達させるため、配線基板を把持させたステージも加熱しておく方が望ましい。加熱された半導体チップ4が、絶縁樹脂層1に接触すると、絶縁樹脂層1が軟化するため半導体チップに形成されたバンプ5は、容易に絶縁樹脂層1を貫通し、バンプ5と配線パターン2が接続される。この接続工程において、半導体チップまたは配線基板のいずれかに超音波振動を印加するようにしてもよい。なお、バンプ5が接続される配線の接続面は、絶縁樹脂層1で既に覆われているため製造工程内での酸化や汚染が防止されている。バンプ5と下層配線との接続は、金属拡散接合や、接触のみで絶縁樹脂で接触保持させる方法のどちらにも適用できる。

【0023】

バンプ先端形状を尖った形状としておくことで、絶縁樹脂層1を掻き分けながら先端が変形していくため、接続の信頼性により有利となる。所望の深さまで半導体チップ4が埋め込まれ、かつバンプと配線の接合が完了した時点で実装ツールの加熱を終了させ、絶縁樹脂層1が十分硬化するまで加圧を保持した後、実装ツールを上昇させる。以上の材料、実装方法により、図1(b)の実装構造を実現できる。

また、本実装構造および製造方法は、チップの回路面に2次配線された半導体チップや、ウェハレベルCSPなどのパッケージングされた電子部品、さらには受動電子部品にも適用できる。

【0024】

図2は、本発明の第2の実施の形態を示す断面図であって、図2(a)には、コア層となる絶縁層12の表・裏面に配線パターン2が形成され、その裏面側にはソルダーレジスト3が塗布され、その表面側にソルダーレジストの機能を果たす熱可塑性樹脂からなる絶縁樹脂層1が形成された配線基板が示されている。図2(b)は、図2(a)の配線基板に第1の実施の形態で説明した方法により半導体チップを実装した断面図である。この実施の形態によれば、絶縁樹脂層1にソルダーレジストと封止樹脂の機能を兼用させることが可能である。

【0025】

このように、絶縁樹脂層に熱可塑性樹脂を用いることにより、従来アンダーフィルを適

用した場合に困難であったリペアも再加熱することで可能となる。また、熱可塑性樹脂の代わりに、エポキシ樹脂などのプリキュア材を用いても、リペアはできないものの、半導体チップの実装は可能である。ここで、熱可塑性樹脂としては、液晶ポリマー、アクリル、ポリエステル、ABS、ポリカボネート、フェノキシ、ポリサルホン、ポリエーテルイミド、ポリアクレート、ノルボルネン系等の各樹脂、また熱硬化性樹脂としては、ビスフェノールA型、ジシクロペンタジエン型、クレゾールノボラック型、ビフェニル型、ナフタレン型等のエポキシ樹脂や、レゾール型、ノボラック型等のフェノール樹脂等が適用でき、これらの複数混合樹脂材料としてもよい。

例えば、熱可塑性樹脂を主成分とし、熱硬化性樹脂を微量添加した樹脂材料である住友ベークライト株式会社製の“IBF-3021”を用いても良好な結果が得られている。すなわち、この樹脂材料を用いて図2(b)のデバイスを作製した場合、温度サイクル試験(-40~125℃)350cycleをクリアしており、民生機器へ適用可能なレベル(300cycle以上)の信頼性は確保されている。

【実施例1】

【0026】

図4は、図1(a)の配線基板を応用し、多層配線層を有する基板への適用した例を示す断面図である。本実施例では、コア層13の両面に配線パターン2と絶縁層を積層して多層配線基板を構成したものであるが、半導体チップ4が実装される層のみに熱可塑性の絶縁樹脂層1を適用している。ここで、絶縁樹脂層1の厚みは30~100 μ m程度である。

絶縁樹脂層1以外は、コア層13にガラスエポキシ基板、また絶縁層12にはビルドアップ絶縁樹脂を用いた一般的な基板構造を想定しており、何れの樹脂にも、熱硬化型樹脂を用いている。絶縁樹脂層1のみを熱可塑性樹脂、他の絶縁樹脂層を熱硬化樹脂で構成していることにより、半導体チップ4を実装する際の熱による絶縁層12やコア層13が軟化変形は非常に小さく、図1(b)と同一の実装工法が採用できることから、多層配線基板への応用も十分可能である。

【実施例2】

【0027】

図5は、図1(b)の実装形態に、ディスペンスあるいはスクリーン印刷法等によってコーティング樹脂14を形成したものであり、半導体チップ上面を樹脂により補強し、表面フラット化を実現した構造である。

この構造の優位性は、本実装構造体に外的応力、例えば落下衝撃・振動・温度サイクルなどによる応力が加わる状態において、半導体チップ4の端面に応力が集中することを防止できるため、接続信頼性を向上でき、適用用途をより拡大することが可能となることにある。

【実施例3】

【0028】

図6は、パッケージングされた電子部品15を配線基板内に埋め込んだ半導体チップ4上に重ねて実装した実施例を示す断面図であって、図1(b)の実装方法にて製造された半導体チップ内蔵の配線基板のパッド電極に、クリームはんだを印刷供給し、電子部品15を搭載してリフローはんだ付けするようにして、表面実装配線基板を実現した例である。

但し、この場合、熱可塑性樹脂である絶縁樹脂層1には、リフロー温度でも半導体チップ4の接続部が破損しない軟化開始温度が高い材料を選定する必要がある。

例えば、液結晶転移点が300℃前後である比較的耐熱性の高い液晶ポリマー材などが絶縁樹脂層1の材料として適用可能である。

【実施例4】

【0029】

図7は、他の半導体チップ16を配線基板内に埋め込んだ半導体チップ4上に重ねて実装した実施例を示す断面図である。半導体チップ4は、図1(b)に示す実装方法にて実装されている。他の半導体チップ16の実装には、従来工法であるフリップチップの圧接

工法や、圧着工法が適用できるが、半導体チップ16を実装する際の熱による半導体チップ4の接続部破壊を防止するため、絶縁樹脂層1の材料には、液結晶転移点が比較的高い前記液晶ポリマー材などが有効である。

また、半導体チップ16を実装する工程において、半導体チップ16下部の凹凸はアンダーフィルの流動性への影響や、ボイドの発生に繋がるため、図5の実施例のようにコーティング樹脂14によって半導体チップ4の上面をフラット化しておくことが望ましい。さらに、半導体チップ16の実装工法として、比較的低い温度で実装可能な超音波併用型のフリップチップ実装工法を採用すれば、絶縁樹脂層1の材料選定範囲を広げることも可能である。

【実施例5】

【0030】

図8は、図1(b)の実装構造体およびその製造工法を応用し、この実装構造体の上下層の何れか、もしくは双方に1層以上の絶縁樹脂層および配線層を積み重ねて構成した多層構造の配線基板例を示す断面図であり、半導体チップを内蔵していることを特徴とする配線基板である。本実施例においては、いずれの絶縁樹脂層1にも、熱可塑性樹脂あるいはプリプレグ等の樹脂が適用できる。ここで、絶縁樹脂層1の厚みは30~100 μ m/層程度である。

図1(b)に示した実装構造は、前述した通り低コスト化を実現できる実装構造であり、同一工法を用いて部品を内蔵させた本部品内蔵配線基板は、一般的な配線基板上に半導体チップを実装する場合に比べて、最終製品の低コスト化が図れるばかりでなく、部品を内蔵させたことによる実装部品の高密度化が図れることから低コストかつ軽薄短小の製品を容易に実現できるというメリットがある。

【実施例6】

【0031】

図9は、図1(b)の実装構造体およびその製造工法を応用し、この実装構造体を配線基板の両面に形成した多層構造の配線基板例を示す断面図である。この実施例では、コア層13の表裏面に配線層および絶縁層12を形成し、さらにそれぞれの表面上に図1(b)の実装構造体を適用して、両面実装構造の多層配線基板を実現している。

【実施例7】

【0032】

図10は、図1(b)の実装構造体およびその製造工法を応用し、この実装構造体を積み重ねて構成した多層構造の配線基板例を示す断面図であり、半導体チップを多層に実装したことを特徴としている。本実施例においては、上層の絶縁樹脂層1には、熱可塑性樹脂あるいはプリプレグ等の樹脂が適用できる。

【実施例8】

【0033】

図11は、図1(a)の配線基板を応用し、多層配線層を有する基板への適用した例を示す断面図である。本実施例は、図4に示される実施例1と同様に、コア層13の両面に配線パターン2と絶縁層を積層して多層配線基板を構成したものであるが、本実施例では、半導体チップ4はそのバンプ5が2層の熱可塑性の絶縁樹脂層1を貫通する態様にて実装されている。この場合に、各々の絶縁樹脂層には、配線パターンを形成してもよく、図4の実施例に比し、より構造上および配線性への自由度を増すことが可能となる。

【実施例9】

【0034】

図12(b)は、図1(b)の実装構造体およびその製造工法を応用し、その上層側の配線層をグランドパターンとして多層構造の配線基板を構成した例を示す断面図であり、図12(a)は、半導体チップを取り外した状態を示す平面図である〔図12(a)において半導体チップの取り付け個所は点線にて示されている〕。本実施例においては、半導体チップ4のバンプは内層配線パターンのパッド20に直接接続されており、そして半導体チップ4のバンプが接続された配線パターンは、他の半導体チップのバンプに直接接続

され、あるいは、ビアホール 22 を介して下層の配線層に落とされる。本実施例においては、最上層の配線層をグラウンドパターン 2a とした配線基板において、半導体チップ 4 のバンプを内層配線層に接続したことにより、半導体チップ周辺にビアホールを形成する必要がなくなり、ビアホール数を削減することができると共に高密度実装が実現できる。この点についてより具体的に説明する。基板上に実装された 2 つ以上のチップを結線し、かつ特にノイズ遮断を目的とした表層にグラウンドベタパターンを配置した場合、信号線は一般的にチップの全端子数の $1/2 \sim 1/3$ であり、他は電源・グラウンド端子である。ここで、仮に 100pin の外部端子を有するチップの 50 端子が信号線であったと仮定すると、従来構造である表層への実装構造では、ノイズ遮蔽のため、全ての信号層を一度内装へビアホールを介して内層へ接続し、表層のグラウンドパターンの下層を通すことでノイズを遮蔽したのち、更にビアホールを介して、内層から結線先の表層のチップに接続する必要がある。表層から内層へ接続するための信号線 50 端子、また内層から表層へ接続するための 50 端子分、合わせて信号線の倍である 100 穴のビアホールが必要となる。これに対し、本発明の直接内層に実装する構造では、直接内層間での結線が可能となることから、この表層と内層間のビアホールが不要となり、これら表層-内層間の 100 穴のビアホール全てを排除することが可能となる。

また、本実施例によれば、グラウンドパターン 2a によって覆われない領域を極小化することができ、シールド効果を高めることができる。

【実施例 10】

【0035】

図 13 (b) は、図 1 (b) の実装構造体およびその製造工法を応用し、積層チップ構造の BGA を構成した例を示す断面図であり、図 13 (a) は、半導体チップを取り外した状態を示す平面図である〔図 13 (a) において半導体チップ 4 の取り付け個所は点線にて示されている〕。本実施例においては、半導体チップ 4 のバンプは内層のパッド 20 に接続され、半導体チップ 4 上には他の半導体チップ 16 がフェースアップ状態で搭載されている。そして、他の半導体チップ 16 の電極（図示なし）と絶縁樹脂層 1 の外周部に配置されたパッド 23 間はボンディングワイヤ 24 により接続されている。配線基板裏面のソルダーレジスト 3 で覆われていない領域にははんだボール 25 が形成されている。本実施例においては、半導体チップ 4 のバンプを内層配線層に接続したことにより、半導体チップ周辺にビアホールを形成する必要がなくなり、ビアホール数を削減することができると共に、半導体チップ 4 に近接させてワイヤボンディング用のパッド 23 を設置することが可能になり、ボンディングワイヤ 24 の長さを最短化することができる。さらに、本実施例によれば、高密度実装が実現できると共に配線層数を削減することも可能になる。

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図 1】 本発明の第 1 の実施の形態を示す工程順の断面図。

【図 2】 本発明の第 2 の実施の形態を示す工程順の断面図。

【図 3】 本発明より実装されるバンプを有する半導体チップの断面図と、半導体チップにバンプを形成する方法を示す側面図。

【図 4】 本発明の実施例 1 の断面図。

【図 5】 本発明の実施例 2 の断面図。

【図 6】 本発明の実施例 3 の断面図。

【図 7】 本発明の実施例 4 の断面図。

【図 8】 本発明の実施例 5 の断面図。

【図 9】 本発明の実施例 6 の断面図。

【図 10】 本発明の実施例 7 の断面図。

【図 11】 本発明の実施例 8 の平面図と断面図。

【図 12】 本発明の実施例 9 の平面図と断面図。

【図 13】 本発明の実施例 10 の平面図と断面図。

【図 14】 従来のフリップチップ実装構造断面とその実装方法を示す断面図。

【図 15】従来の他のフリップチップ実装構造断面図とその実装方法を示す断面図。

【図 16】最上層にランドパターンを有する配線基板に従来法によりフリップチップを実装した状態を示す平面図と断面図。

【図 17】従来法により積層した半導体チップの BGA を構成した状態を示す平面図と断面図。

【図 18】薄型チップを実装ツールで吸着把持した状態を示す模式図。

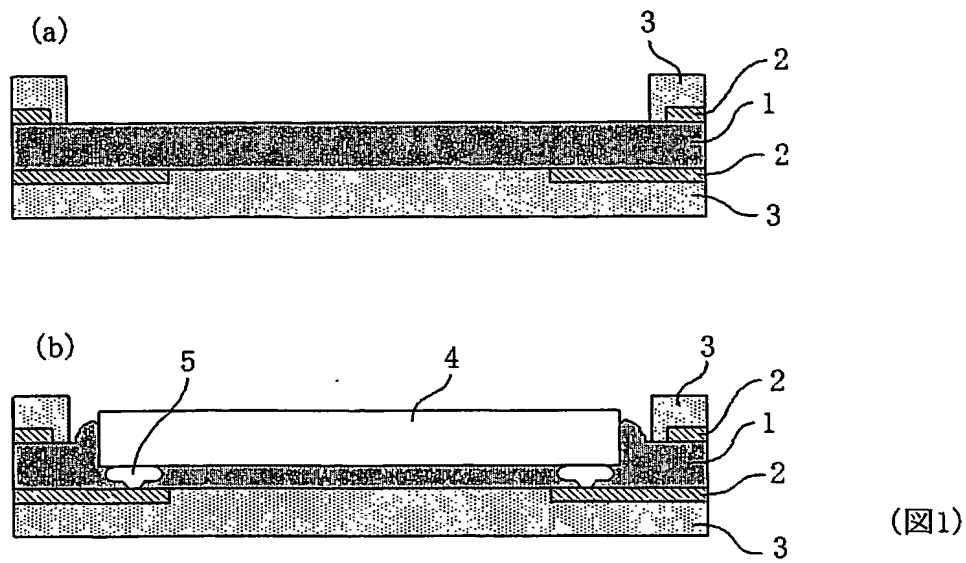
【符号の説明】

【0037】

- 1 絶縁樹脂層
- 2 配線パターン
- 2 a グランドパターン
- 3 ソルダレジスト
- 4 半導体チップ
- 5 バンプ
- 6 キャピラリ
- 7 金ワイヤ
- 8 金ボール
- 9 ボンチ
- 9 a 凹部
- 10 ダイス
- 11 リボン材料
- 12 絶縁層
- 13 コア層
- 14 コーティング樹脂
- 15 電子部品
- 16 他の半導体チップ
- 17 アンダーフィル
- 17 a 液状樹脂
- 18 実装ツール
- 19 吸着穴
- 20、23 パッド
- 21 ビアホールランド
- 22 ビアホール
- 24 ボンディングワイヤ
- 25 はんだボール

【書類名】 図面

【図 1】



1 絶縁樹脂層

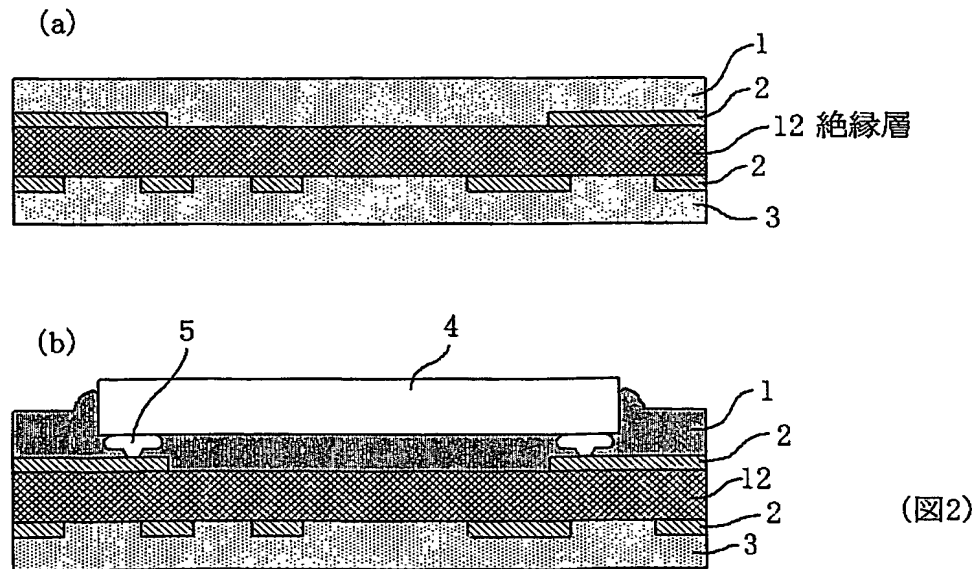
2 配線

3 ソルダーレジスト

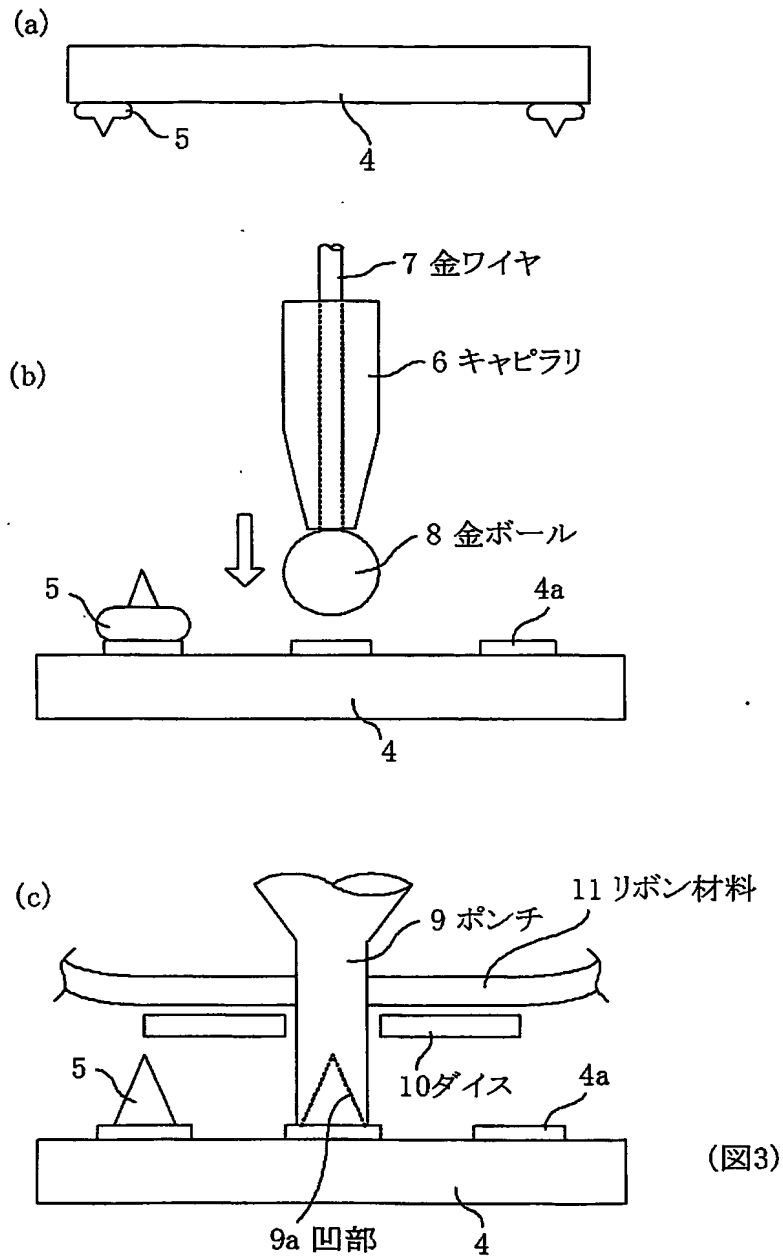
4 半導体チップ

5 バンプ

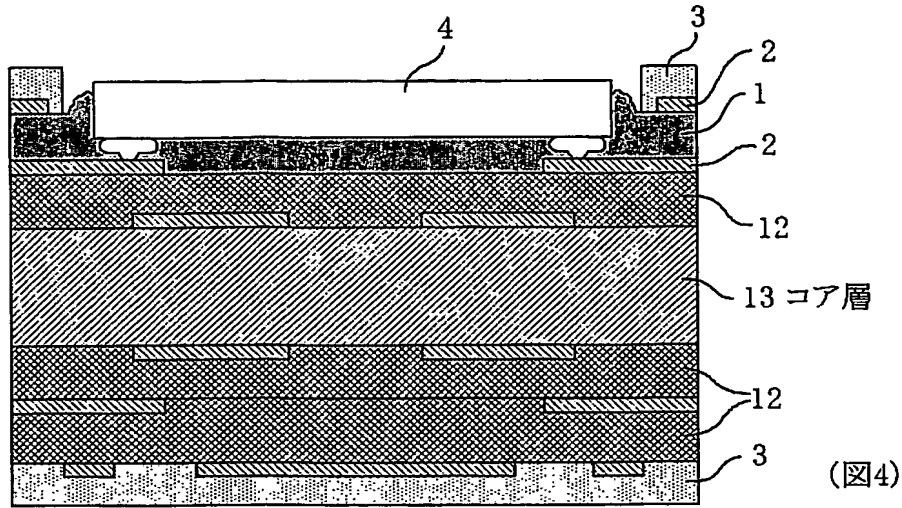
【図 2】



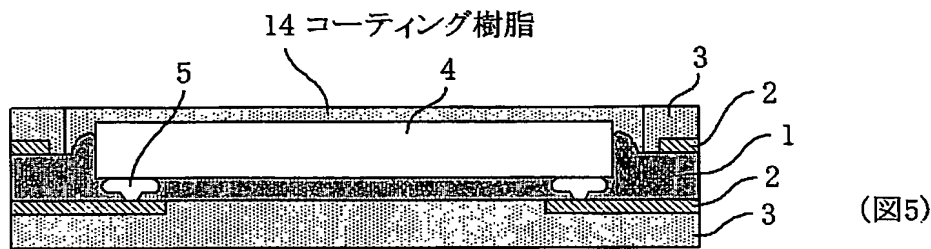
【図 3】



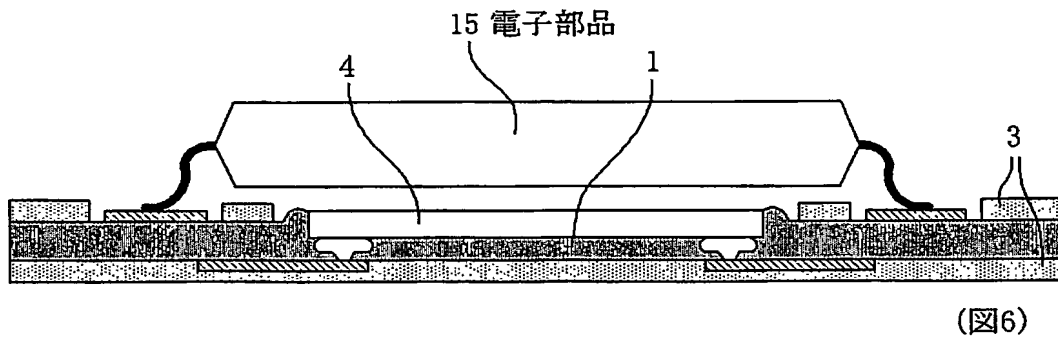
【図 4】



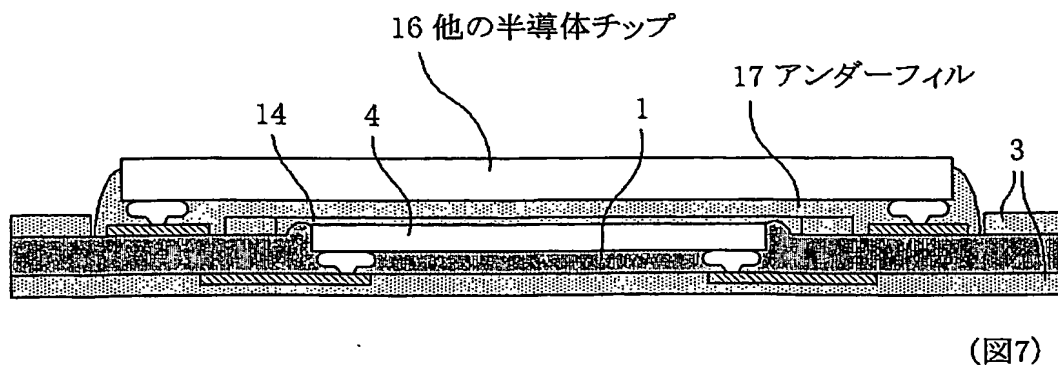
【図 5】



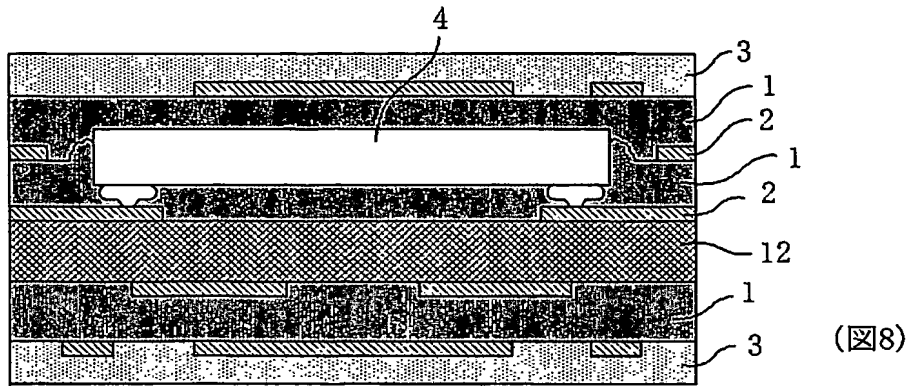
【図 6】



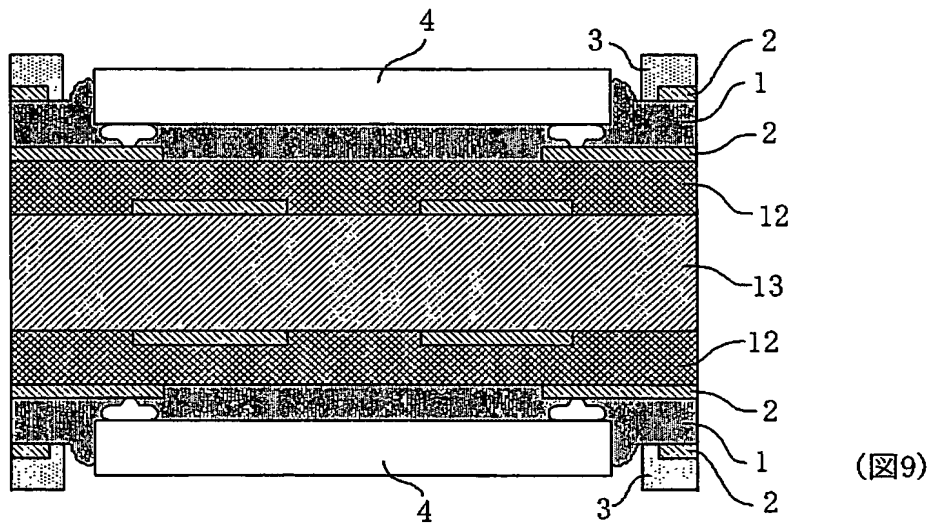
【図 7】



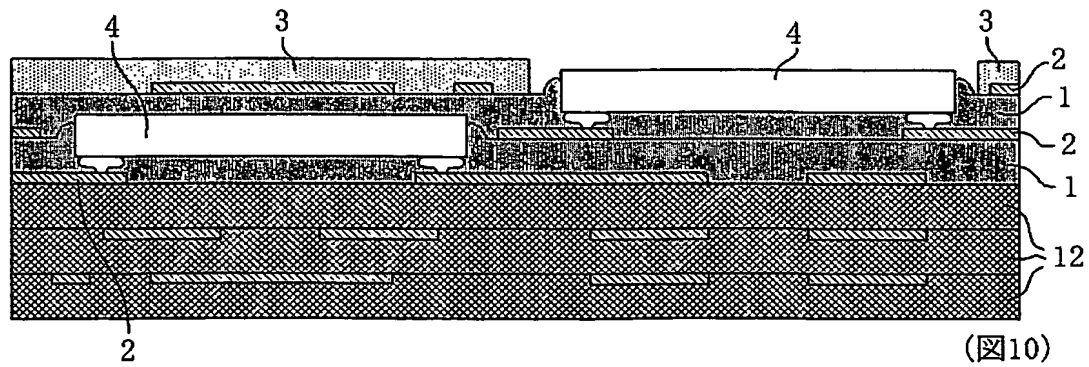
【図 8】



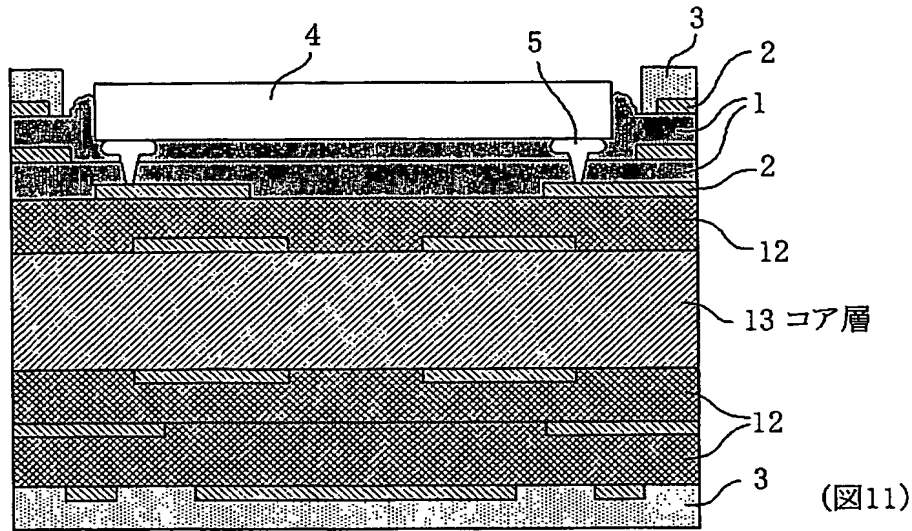
【図 9】



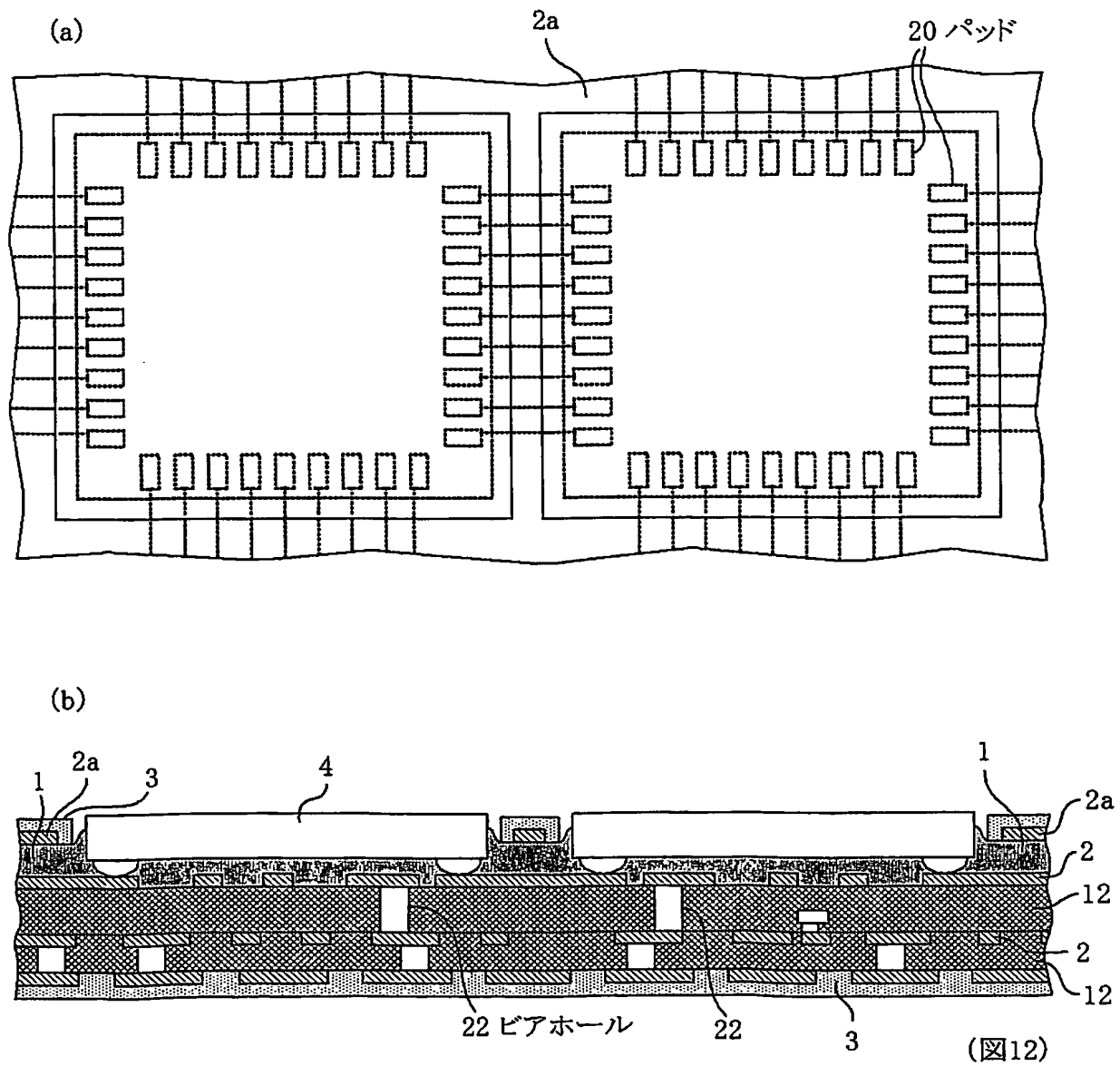
【図 10】



【図 11】

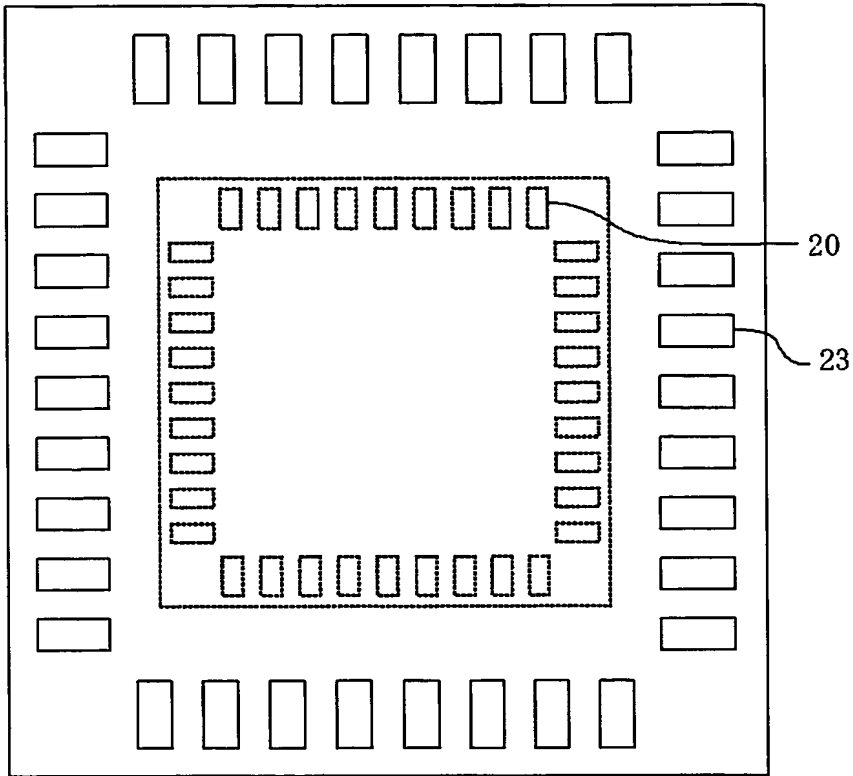


【図 12】

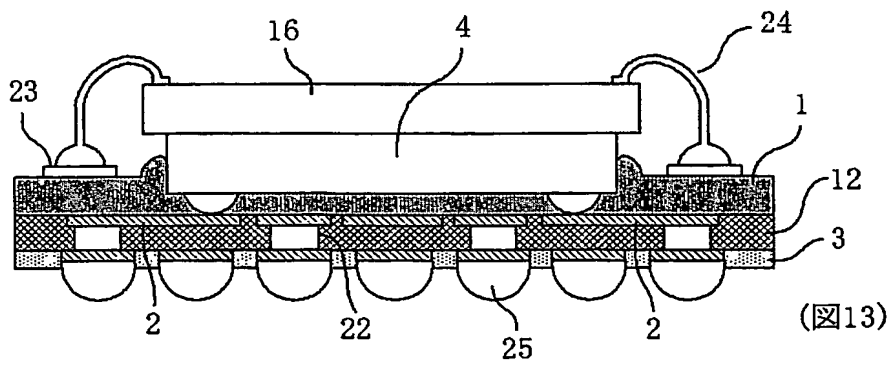


【図 13】

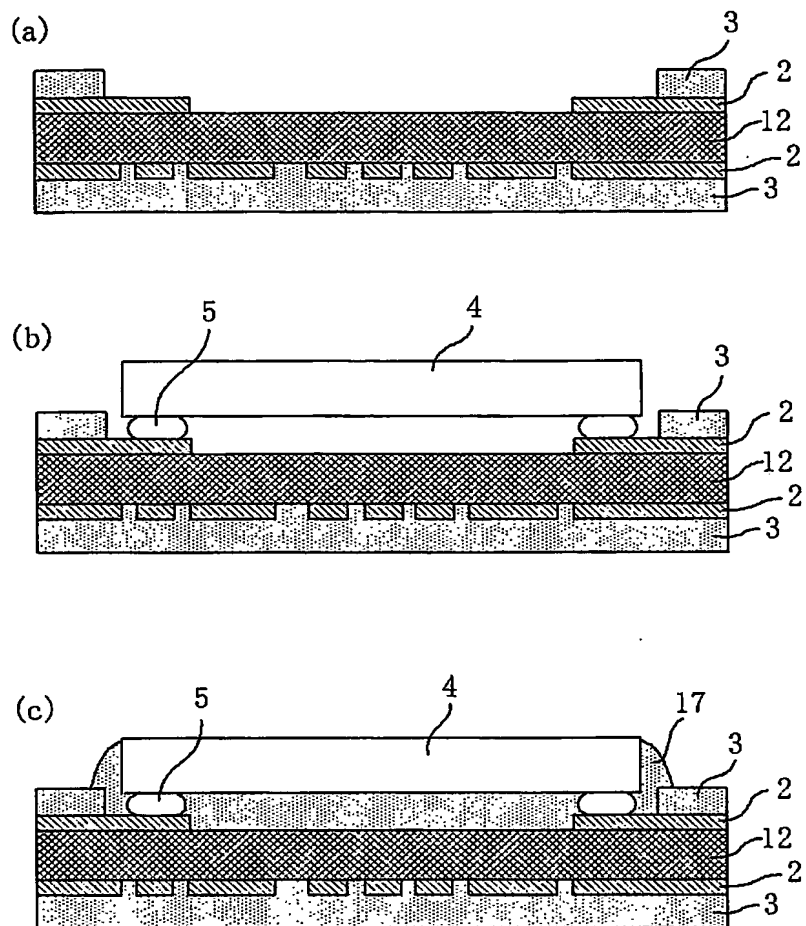
(a)



(b)

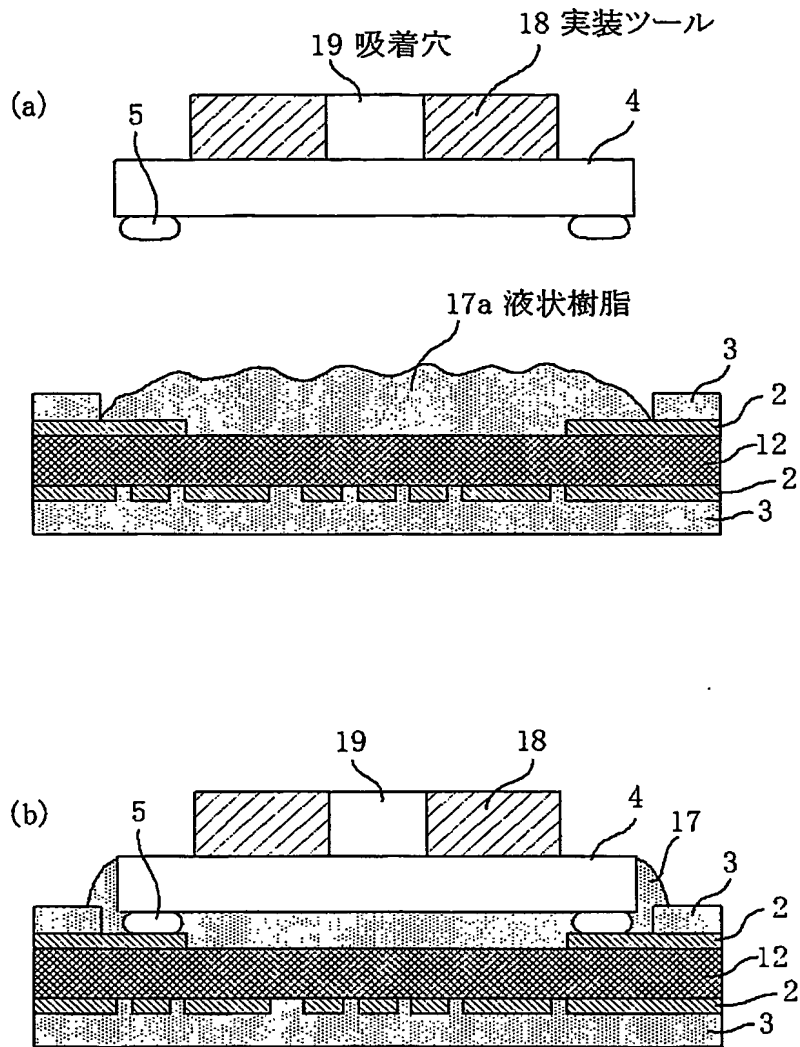


【図 14】



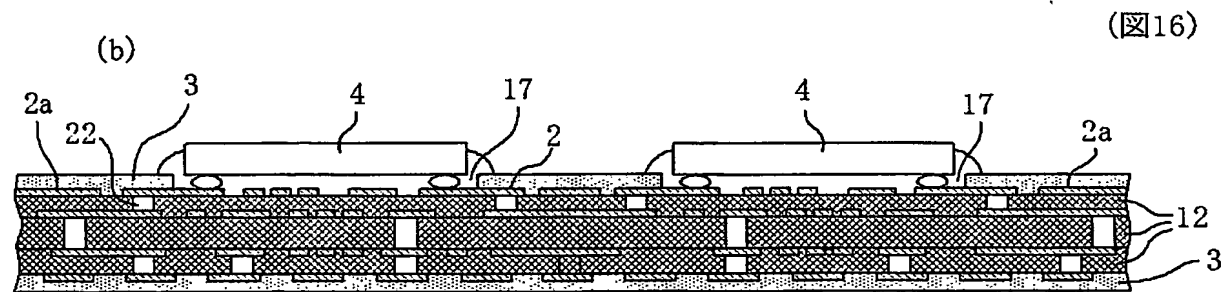
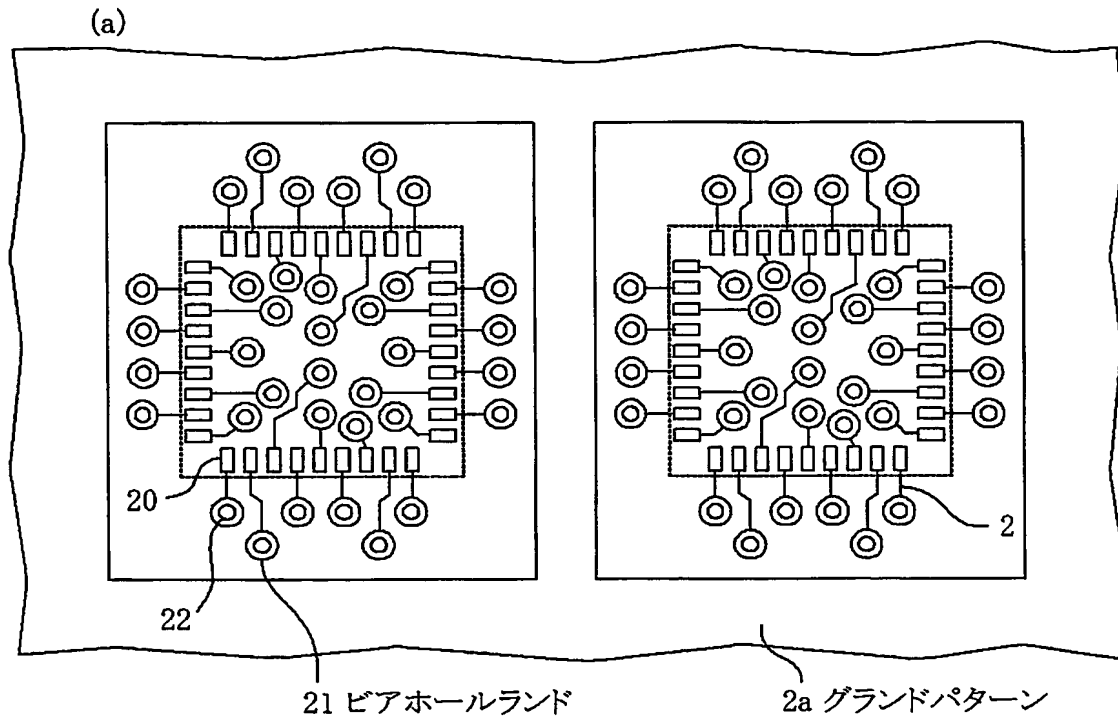
(図14)

【図 15】

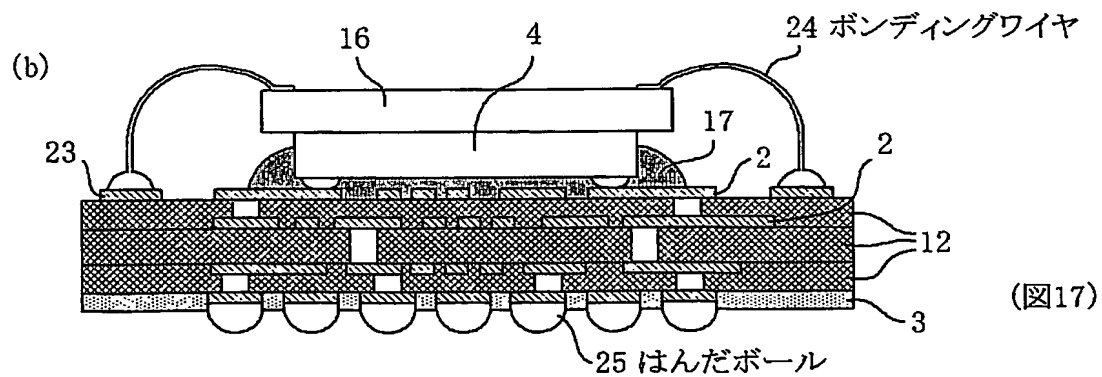
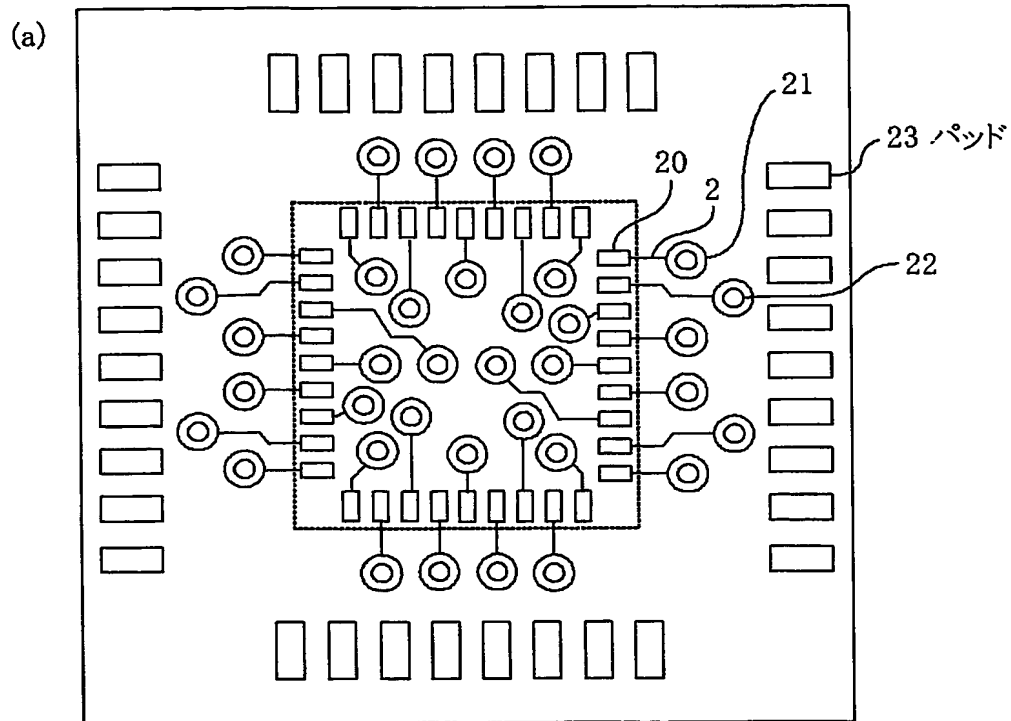


(図15)

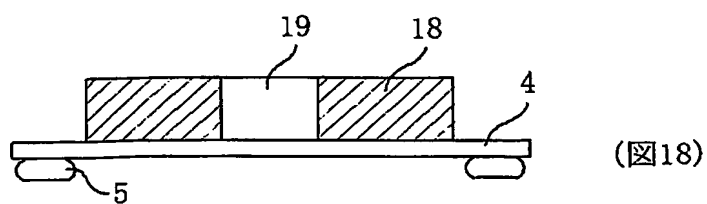
【図 16】



【図 17】



【図 18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ベアチップの実装工程において、アンダーフィルを供給する必要のない低コストで、かつ小型・高信頼性を実現する実装構造とその製造方法を提供する。

【解決手段】 配線基板の絶縁樹脂層 1 に熱可塑樹脂を適用し、半導体チップ 4 に形成されたバンプを絶縁樹脂層 1 を貫通させ下層の配線に接続した実装構造としたことにより、実装工程においてアンダーフィルの供給が不要であることから大幅な低コスト化を実現できるとともに、半導体チップを基板内に内包させることが可能となり薄型・小型・高密度の半導体パッケージを容易に実現できる。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-346580
受付番号	50301656537
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年10月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年10月 6日
-------	-------------

特願 2 0 0 3 - 3 4 6 5 8 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

氏 名

日本電気株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.